

技術・製品概要（やまぐち自動車産業技術・製品紹介特設ウェブサイト）

|  |   |                                |                                |                                      |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| A: 区分                                      | <input type="checkbox"/> 部品   | <input type="checkbox"/> 素材/材料 | <input type="checkbox"/> 設備/装置 | <input type="checkbox"/> システム/ソフトウェア |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> その他（加工請負）   |                                |                                |                                      |
| B: 技術・製品名                                  |   |                                |                                |                                      |
| <b>超微細ダイシングカット</b>                         |   |                                |                                |                                      |
| C: 技術・製品の概要                                |   |                                |                                |                                      |
| シリコンウェハやアルミナなどのセラミック薄膜基板を超微細にダイシングカット致します。 |   |                                |                                |                                      |
| D: 企業情報                                    |   |                                |                                |                                      |
| 企業名:                                       | リード株式会社   | 設立:                            | 1975年                          |                                      |
| 所在地:                                       | 山口県宇部市大字善和字石ヶ谷591-4   | 資本金:                           | 1000万円                         |                                      |
| 電話番号:                                      | 0836-62-1531  | 従業員数:                          | 20名                            |                                      |
| 事業内容:                                      | 【ダイシング事業】アルミナ・窒化アルミ・シリコンウェハ・SiCなど主にセラミック素材をダイシングカットしています。<br>【その他受託加工事業】電極印刷・パッド印刷・焼成・外観検査・組立・配線など<br><a href="https://www.lead-company.jp/">https://www.lead-company.jp/</a> |                                |                                |                                      |

<< 技術・製品の内容 >>

|  |   |
|--|---|
| E: セールスポイント  | F: 適用可能な製品/分野   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>高精度にダイシングカット致します。</li> <li>基板収縮に追従したダイシングカットを行うことができます。</li> <li>チップングをできるだけ抑えたい・とにかく歩留重視などお客様の様々なニーズに対して最適なダイシングプログラム・各種条件をご提案致します。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>半導体部品（シリコンウェハなど）</li> <li>電子部品（アルミナ・窒化アルミ薄膜基板など）</li> <li>自動車部品（プリント基板など）</li> </ul> |

G: 紹介内容（以下太枠内）

|   |   |  |                                  |        |        |
|---|---|--|----------------------------------|--------|--------|
| 技術・製品の内容  |   |  |                                  |        |        |
| <b>工程フロー</b>  |   |  |                                  |        |        |
|   |   |  |                                  |        |        |
|   |   |  |                                  |        |        |
| <p>ダイシングとは？<br/>さいころ（ダイス）のようにカットすることが語源になっています。</p> <p>半導体業界・電子部品業界では広く認知されている手法です。<br/>自動車業界におきましてもカーエレクトロニクスによる半導体・電子部品の需要増によって独自に半導体・電子部品を製造される会社様も増えてきているようにお聞きしています。<br/>業界の垣根が無くなってきている今、弊社ではダイシングが可能です。<br/>カット手法などでお困りの際には弊社にお問い合わせ頂けると幸いです。</p> <p>様々な業界の様々なワークを45年以上加工・外観検査している実績があり、自動車部品に関しましてはダイシングだけでなくハンドル部分やウインカー・ワイパーの表面実装・組付け・半田付け・外観検査などの経験があります。<br/>1シートから採取できるチップ数を増やしたい・シートが収縮していて良品が採取できる範囲が少ないなどについてもご相談頂けると経験値を活かして最良なご提案を致します。</p> |   |  |                                  |        |        |
| 提案の狙い   |   |  | 問題点（課題）と対応方法                     |        |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 原価低減  | <input checked="" type="checkbox"/> 品質/性能向上 | <ul style="list-style-type: none"> <li>対応不可なサイズ・厚みがあります⇒先ずはご相談お願い致します。</li> <li>対応不可な素材があります⇒先ずはご相談お願い致します。</li> </ul> |                                  |        |        |
| <input type="checkbox"/> 質量低減   | <input type="checkbox"/> 安全/環境対策            |  |                                  |        |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 生産（作業）性向上   | <input type="checkbox"/> その他（ ）             |  |                                  |        |        |
| 開発進度  | （ 2021 年 12 月 現在）                           |  |                                  | 特許の有無  |        |
| <input type="checkbox"/> アイデア段階   | <input type="checkbox"/> 試作/実験段階            | <input checked="" type="checkbox"/> 開発完了段階   | <input type="checkbox"/> 製品化完了段階 | 無      |        |
| 従来との比較  | 項目  | コスト  | 質量                               | 生産/作業性 | その他（ ） |
|   | 数値割合  |  |                                  |        |        |